ADIC353

## 性能特点

• RF/LO频率范围: 20 GHz - 55 GHz

IF频率范围: DC - 16 GHz变频损耗: 9 dB(典型值)

• LO-RF隔离度: 30 dB(典型值)

射频输入P1dB: -3 dBm本振驱动功率: 8 dBm

• 直流供电: Vg= -0.5 V

• 芯片尺寸: 1.60 mm×2.00 mm×0.07 mm

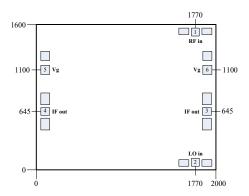
# 产品简介

ADIC353是一款Q波段宽带混频器芯片, 频率范围覆盖20 GHz - 55 GHz, 变频损耗典 型值为9 dB, 本振-射频隔离度典型值为30 dB, 射频输入P1dB为-3 dBm。

# 极限参数

射频输入功率	10 dBm
本振输入功率	15 dBm
栅极负电压	-1 V
存储温度	-65 °C~150 °C
使用温度	-55 ℃~85 ℃

# 外形尺寸



注: 1) 所有标注尺寸单位为微米(µm);

2) 外形长宽尺寸公差: ±50 μm;

3) 芯片厚度70 µm。

## 键合压点定义

编号	符号	功能描述	尺寸(µm²)	
1		射频信号输入端,	86×72	
	RF in	外接50欧姆系统,		
		无需隔直电容。		
2 LO in		本振信号输入端,		
	LO in	外接50欧姆系统,	86×86	
		无需隔直电容。		
3、4		中频信号输出端,		
	IF out	外接50欧姆系统,	100×100	
		片上无隔直电容。		
5、6 Vg		栅极电压馈电端,		
	\/a	需外置100 pF和	100×100	
	vg	10000 pF旁路电		
		容。		

**电性能表** (T<sub>A</sub>= +25 ℃, LO= 8 dBm, Vg= - 0.5 V)

参数名称	最小值	典型值	最大值	单位
射频频率范围	20		55	GHz
本振频率范围	20		55	GHz
中频频率范围	DC		16	GHz
SSB变频损耗	8	9	10	dB
本-射隔离度	20	30	50	dB
射频输入P1dB		-3		dBm
本振功率	6	8	13	dBm
射频端口驻波	1.2	2	3.5	-
中频端口驻波	1.3	1.5	2	-



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS



关注公众号

更新日期: 2023-12-01

ADIC353 V0

服务热线: 028-61399584

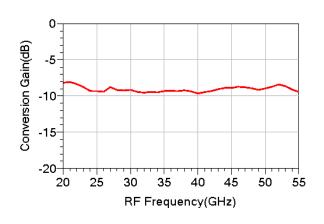
## **在片测试曲线** (T= +25 ℃)

# Freq IF= 1 GHz, Freq IF=Freq RF-Freq LO;

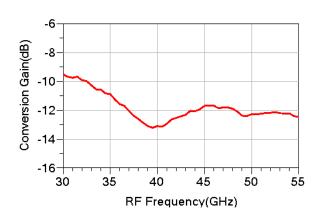
# 在片测试曲线 (T= +25 ℃)

Freq LO= 29.6 GHz, Freq IF=Freq RF-Freq LO; Pwr RF= -15 dBm, Pwr LO= 8 dBm, Vg= -0.5 V Pwr\_RF= -15 dBm, Pwr\_LO= 8 dBm, Vg= -0.5 V

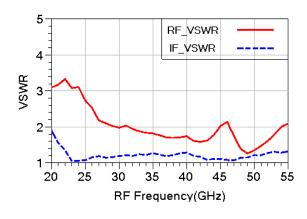
#### SSB变频损耗vs.射频频率(单IF端口)



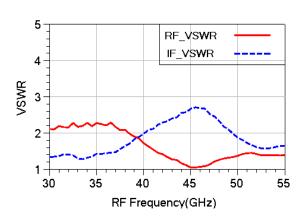
#### SSB变频损耗vs.射频频率(单IF端口)



# 射频/中频驻波vs.射频频率

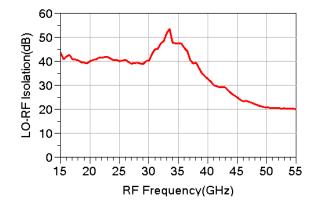


射频/中频驻波vs.射频频率



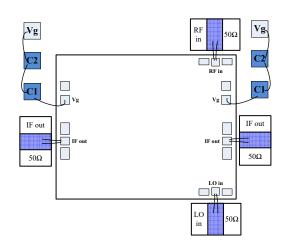
更新日期: 2023-12-01

本振-射频隔离度vs.射频频率



ADIC353

### 建议装配图



注: 外围电容C1容值为100 pF, C2容值为10000 pF, 其中C1推荐使用单层电容,并尽量靠近芯片键合压点。

# 注意事项

1.存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

2.清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

3.静电防护:请严格遵守ESD防护要求,避免静电损伤。

4.常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

5.加电顺序: 加电时,先加栅压,后加漏压; 去电时,先去漏压,后去栅压。

6.装架操作: 芯片安装可采用AuSn焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺,安装面必须清洁平整,芯片与输入输出射频连接线基板的缝隙尽量小。

7.烧结工艺: 用80/20 AuSn烧结,烧结温度不能超过300 ℃,烧结时间尽量短,不要超过20秒,摩擦时间不要超过3秒。

8.粘接工艺: 导电胶粘接时点胶量尽量少, 固化条件参考导电胶厂商提供的资料。

9.键合操作:无特殊说明,射频输入输出用2根键合丝(直径25 µm金丝),键合线尽量短。热超声键合温度150 ℃,采用尽可能小的超声能量。球形键合劈刀压力40~50 gf,楔形键合劈刀压力18~22 gf。10.有问题请与供货商联系。

服务热线: 028-61399584

更新日期: 2023-12-01